



第 20 回電子デバイス実装研究委員会 公開シンポジウム

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。下記のとおり、第 20 回 電子デバイス実装研究委員会を、同部会・樹脂実装研究会との公開シンポジウムとして開催いたします。

樹脂実装研究会では、電子デバイス実装に用いられる樹脂材料の特性を調査・整理するとともに、金属、無機材料との界面現象・構造を明確にし、樹脂実装部の長期信頼性確保の指針を示すことを目的として、活動を続けて参りました。この度、電子デバイス実装研究委員会の定例委員会を公開シンポジウムとし、最新の樹脂材料に関する講演ならびに研究会の成果報告を行います。今後飛躍的な普及が期待される樹脂実装技術についての公開シンポジウムです。聞き逃さない内容となっておりますので、皆様のご参加をお待ち申し上げます。

主催 (一社) スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会
共催: (一社) エレクトロニクス実装学会

開催日時

平成 29 年 11 月 29 日 (水) 10:30~16:45

開催場所

日本橋ライフサイエンスビルディング 201 大会議室
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目 3 番 11 号

定員

先着 100 名 [申込み締切り:平成 29 年 11 月 20 日 (月)]

参加費

10,000 円 (非会員、資料代含む)

申込方法

以下のエレクトロニクス生産科学部会ホームページの申込みフォームよりお申込み下さい。
<http://sps-mste.jp/committee/>

※お支払いは、受付完了メールに記載された振込先まで銀行振り込みにてお願いいたします。

※電子デバイス実装研究委員会会員の方は上記申込フォームからのお申し込みは不要です。別途ご案内をお送りいたしますので、通常の手続きにてお申込みください。

プログラム

10:30 ~ 11:50	『自動車分野におけるパワーエレクトロニクス製品の課題と 分析・評価技術』 『次世代パワーデバイス向け高耐熱高放熱接着シートの開発』	(株)デンソー 野村 匠氏 (株)ADEKA 森 貴裕氏
11:50 ~ 13:00	休 憩	
13:00 ~ 14:45	『シミュレーションを活用した最適樹脂設計手法の検討』 『導電性接着剤における界面制御』 『電子機器実装用低温・短時間硬化接着剤』	ナミックス(株) 榎本 利章氏 群馬大学 井上 雅博氏 富士通クリティカル(株) 伊達 仁昭氏
14:45 ~ 15:00	休 憩	
15:00 ~ 16:45	『3次元 UV リソグラフィ法とそのポリマーMEMS 応用』 『ナノインプリント技術の現状と今後の展望 —量産プロセス技術への展開を目指して—』 『分子接合技術の紹介』	群馬大学, JST さきがけ 鈴木 孝明氏 東芝機械(株) 後藤 博史氏 (株)東芝 八甫谷 明彦氏

※プログラムは当日変更となる場合があります。

■ 問合せ先: mste@sps-mste.jp (スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会事務局)